

ST	개	리														수 정 내 용				
																부	호	내 용	수정자	승인자
ST(기초)															1	[설번No.201508-0019]BODY 님시 바늘 추가	이현진	김인철	2015. 08. 31.	
ST(개선)															2	[설번No.201912-0006] 절연체 동축 병자로 인한 배다 님시바늘 및 절연체 치수 변경	은선영	김인철	2019. 12. 11.	

주 기

1. 재질

- 1.1 몸체 : KS-D-5101 C3604BD-F 쾌삭황동봉
- 1.2 접촉핀 : KS-D-5101 C3604BD-F 쾌삭황동봉
- 1.3 절연체 : SAE-AS1946 또는 동등한 재료 (PTFE 테프론)

2. 보호피막처리 : 접촉핀은 MIL-DTL-45204, type II, class I

몸체는 MIL-DTL-45204, type II, class 00에 따라 처리 할 것

3. 전기적특성

- 3.1 특성 임피던스 : 50Ω
- 3.2 절연저항 : 1,000MΩ 이상
- 3.3 접촉저항 : 6.0mΩ 이하
- 3.4 D.W.V : AC 750Vrms 이상에서 1분간 견딜 것

4. 모든 덧살 및 날카로운 모서리를 제거할 것

5. 모든 치수는 참고 치수임

6. 관련도면 : A2 50073585

A2 50073630

A2 50084982

A2 50085005

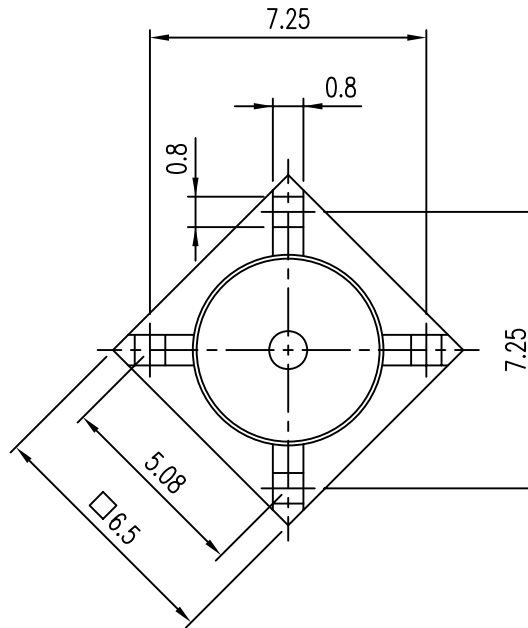
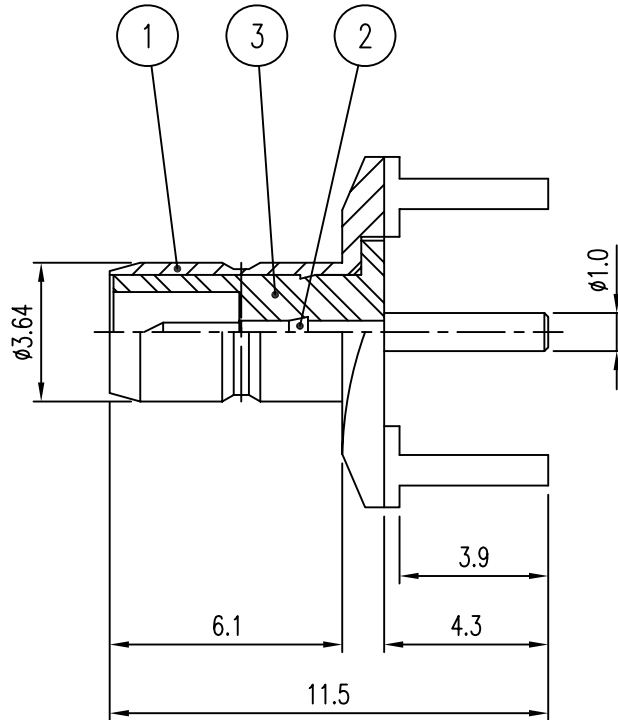
A2 50085269

A2 50085282

A2 50085286

A2 50085365

A2 50085394



2	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00309-N/1 (H3025)
	2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate (1.27μm)	DCT00394-5/1 (E3017)
	1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	산무 Gold Plate (0.508μm)	DBD00489-5/2 (D3022)
	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

대체가능재질	년월일	2019. 12. 11.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
공통공차	승인	I.C.KIM				
소수 각도 분수	검도					
재질	제도	S.Y.EUN				
열처리	작성부서	연 구 소				
보호피막처리	적도	5/1	단위	mm	중량	

KJ COMTECH
RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 **SMB50 PCB JS-4R**

도번 **CN01104-7/1**
K315-426-000